

2025年1月10日

各位



【出展のお知らせ】第39回ネプコン ジャパン -エレクトロニクス開発・実装展-

当社は「第39回ネプコンジャパン」に出展いたします。

今回は、「エレクトロニクス実装・検査・出荷工程でのスマートファクトリー向けソリューション」を出展テーマとしております。この機会に是非、当社ブースにお立ち寄りください。

第39回
ネプコン ジャパン
エレクトロニクス開発・実装展

会 期 : 2025年1月22日(水)～1月24日(金)

開場時間 : 10:00～17:00

会 場 : 東京ビッグサイト 東ホール

当社ブース : E17-40

問い合わせ先 : (株)南陽 産機事業本部 ASS部 [TEL:092-473-7711](tel:092-473-7711)

【デモ実演エリア】**【NEW!】**

スマートファクトリーを模した製造工程間の搬送・組立をAMRと双腕型ロボットで実演!

- (1) 全方向への移動が可能な球駆動型AMR2台で1台の台車を持ち上げ、
先導AMRによる安全確認を行い目的地に3台で搬送。
- (2) 5本指の人型双腕ロボットが搬送された材料を組立し、製品を梱包。
- (3) 人型双腕ロボットは、作業者の動きを模倣することで煩雑なプログラミング作業を簡略化。

【製造ライン向けRPAエリア】**【NEW!】**

「AI」を用いたRPAで製造ラインの装置を個別制御し、一括管理や稼働率アップを行うソフトウェア

- (1) 各製造装置を「AIを用いたRPA」で遠隔監視、操作、自動エラー復旧を実施。
(実績: ダイシング～外観検査～ダイボンド～ワイヤボンド～モールド封止)

【製造ライン向け取扱い装置紹介エリア】

<前工程>

- (1) R&D向け露光、リフトオフ、コーター(4, 6, 8インチ)装置
- (2) ウェハー貼り合わせのズレ検査装置
- (3) 超高速で小チップから大チップまで外観分類しながら選別移載するウェハーリング移載装置

<後工程>

- (4) サブ μ m 精度でウェハー内部、表裏を2D&3D 検査するウェハー検査装置
- (5) パワーデバイス及びメモリーパッケージ向け多段チップや交差するワイヤの3次元外観検査装置
- (6) 全ワイヤボンドの金属接合界面品質を非接触で全自動検査するレーザーボンドテスター
- (7) AMR とドッキング可能なパッケージ、チップレット、CMOS センサーモジュールの外観選別機
- (8) SMD 部品、IC パッケージ、FPC 基板などを水と超音波の力で精密洗浄する連続式超音波洗浄機

【製造ライン向け装置デモエリア】

- (1) 最先端オープンクリーンシステム (KOACH) : ものづくり日本大賞、内閣総理大臣賞
- (2) LED 照明のハレーションや影の不具合を解消する新光学照明ソリューション (Phaseray)

【来場登録専用 URL】 <https://x.gd/YjpUs>

当社ブース : E17 - 40



【展示ブースイメージ】



以上